

使用上の注意（実装上の注意）

1. 基板設計（ランド寸法）

グランド端子は、全てグランドパターンに接続してご使用ください。また、IN、OUT間には、必ずグランドパターンを設けてください。

推奨ランド，パターン寸法は、弊社の標準のものです。実機実装状態では、周辺のシールド・その他部品の配置およびパターンの引き方・グランドの取り方・グランドの強さ・NC端子の取り付けランドの有無・寸法・基板の種類・厚みなどにより特性が変動する場合があります。

当推奨ランド以外でご使用になる場合は、必ず実機実装状態での特性確認を行ってください。

2. はんだ付け条件

はんだ温度と部品表面の温度差（ T ）が下表の範囲となるよう十分な予熱を行ってください。また、取り付け後、溶剤への浸せきなどより急冷される場合は、温度差が100以内となるよう配慮してください。

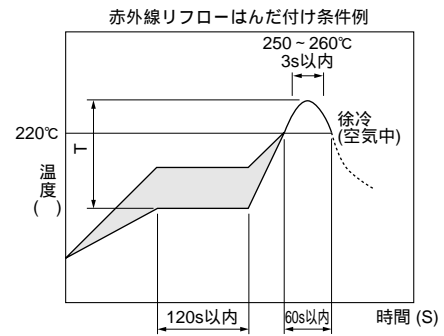
当製品は、上記はんだ付け条件以外で使用される場合、製品に損傷を与える場合がございます。（外部電極くわれ、クラックなど）当条件以外でご使用になる場合は、あらかじめ弊社にご連絡ください。

はんだ付け方法	温度
コテ付け法	T 130
リフロー法	

ただし、コテ付けの場合のはんだコテは、下表条件にてご使用ください。

項目	コテの種類	
	ニクロム・ヒータ	セラミック・ヒータ
はんだコテのワット数	30W以下	18W以下
コテ先温度	280 以下	250 以下

コテ先の直径： 3.0mm以下のコテをご使用ください。
はんだ付けの際はコテ先が直接セラミック素地に触れないようにしてください。



フラックスをご使用になる場合は、ロジン系のフラックスまたは、塩素含有率0.2wt%以下の弱活性フラックスを使用してください。また、製品の周囲にフラックスの残渣が残らないようにご使用ください。

フラックス残渣により特性劣化、絶縁抵抗の低下の可能性ががあります。

はんだ盛量

はんだが外部電極の端面部になめらかに0.2～0.5mmまで上がっていることをご確認ください。はんだ盛量がこれより少ない時や多すぎる時は、機械的強度の劣化や電気的性能の変動が起きる場合があります。